

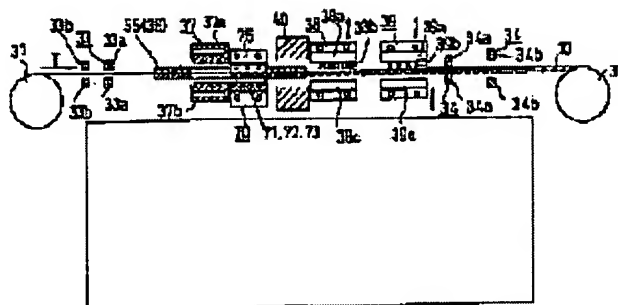
**EMBOSSSED TAPE MAKER AND EMBOSS MOLDING DIE**

**Patent number:** JP10273107  
**Publication date:** 1998-10-13  
**Inventor:** NAGASAWA TSUTOMU; KATO HIROSHI; KATO TOMOYASU; MITSUBE NAOYUKI  
**Applicant:** SHIN ETSU POLYMER CO LTD  
**Classification:**  
- **International:** B65B15/04; B29C51/42; B29C59/02  
- **European:**  
**Application number:** JP19970092754 19970328  
**Priority number(s):**

**Abstract of JP10273107**

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide an embossed tape maker which can prevent thermal influence at the time of molding and an emboss molding die for pressure-forming which can highly accurately mold embosses.

**SOLUTION:** The embossed tape maker comprises a hot disk 37 for heating a tape along a travel path of the tape which is wound so that it can travel from a feed-out reel 31 toward a take-up roll 32, an emboss molding die 70 for forming storage recesses on the tape, a tape temperature adjuster 40 for adjusting a temperature of the tape to a predetermined temperature, a feed hole punch mold 38 for forming feed holes on the tape, and a sensing hole punch mold 39 for forming sensing holes on the tape, while guide members 35, 36 to be cooled by a coolant are extended over a predetermined range on both sides of a range including the hot disk 37 and the emboss molding die 70 of the tape travel path, so that both sides of the traveling tape are cooled in slide contact with the guide members 35, 36.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平10-273107

(43) 公開日 平成10年(1998)10月13日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号

F I

B 6 5 B 15/04

B 6 5 B 15/04

P

B 2 9 C 51/42

B 2 9 C 51/42

59/02

59/02

B

審査請求 未請求 請求項の数 4 F D (全 8 頁)

(21) 出願番号

特願平9-92754

(22) 出願日

平成9年(1997)3月28日

(71) 出願人 000190116

信越ポリマー株式会社

東京都中央区日本橋本町4丁目3番5号

(72) 発明者 長沢 務

埼玉県大宮市吉野町1丁目406番地の1

信越ポリマー株式会社東京工場内

(72) 発明者 加藤 浩

埼玉県大宮市吉野町1丁目406番地の1

信越ポリマー株式会社東京工場内

(72) 発明者 加藤 知康

埼玉県大宮市吉野町1丁目406番地の1

信越ポリマー株式会社東京工場内

(74) 代理人 弁理士 薬師 稔 (外1名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 エンボステープ製造装置およびエンボス成形金型

(57) 【要約】

【課題】 成形時の熱影響を防止できるエンボステープ製造装置、また、エンボスを高精度に成形できる圧空成型用のエンボス成形金型を提供する。

【解決手段】 繰出リール31から巻取リール32に向かって走行可能に掛装されたテープの走行経路に沿ってテープを加熱する熱盤37、テープに収納凹部11を形成するエンボス成形金型70、テープを所定温度に温度調節するテープ温調器40、テープに送り孔12を形成する送り孔パンチ金型38およびテープに検知孔15を形成する検知孔パンチ金型39を配設するとともに、テープ走行経路の熱盤37とエンボス成形金型70を含む範囲の両側に冷却媒体により冷却されるガイド部材35、36を所定範囲にわたって延設し、走行するテープの両側部をガイド部材35、36に摺接させて冷却するように構成した。

